

Compression Molding System

Model CPM1080



**Compression molding system for high-quality and
low-cost WLP/PLP molding processes**

高品質・低コストの WLP・PLP成形プロセスを実現する コンプレッションモールド装置

製品情報



日本語

- 1台の設備で顆粒／液状樹脂に対応
- 独自開発のコンプレッション技術を核としたウェハレベルモールド、パネルレベルモールドを実現
- ディスペンサユニットに樹脂の自動計量・自動補填機能を搭載
- 自社製搬送ロボットで大きい反り、高重量の搬送を実現
- プリカット方式を採用。1成形あたりのフィルム使用量を約25%削減(当社比)



Wafer type



Panel type

SPECIFICATION

Items		Unit	Description			
モデル		—	CPM1080			
ワークタイプ		—	パネル・ウェハ			
装置区分		—	Manual	Semi-Auto	Full-Auto	
ワークサイズ	パネル	mm	□320 (Max.)		□150—320	
	ウェハ	mm	φ 320 (Max.)			
樹脂		—	顆粒・液状			
マシンタイム		sec	—	—	Approximately 75	
外形寸法	プレス数	module	1	1	1	2
	幅	mm	1,388	2,950	3,910	4,590
	奥行き	mm	1,650	2,010	2,180	2,180
	高さ	mm	1,980	1,980	1,980	1,980
重量		ton	4.4	6.3	7.0	10.6
成形取り数		workpiece	1	1	1	2
マガジンスペース		—	—	—	FOUP Input / Output stage : 1 cassette each	
クランプ出力		kN／(tf)	98.0—784.0／10.0—80.0			
クランプ速度		mm／sec	100 (Max.)			
リリースフィルム幅		mm	440 (Max.)			
オプション	チップ数カウント	—	—	—	○	○
	パッケージ外観検査	—	—	—	○	○
	パッケージ厚み測定	—	—	—	○	○
	アフターキュア	—	—	—	○	○
	ディスペンサ	—	—	○	○	○

・上記数値は当社標準機の場合です。
・ディスペンサモジュールを含む場合、外形寸法は幅680mm追加となります。
・改良のため仕様を変更する事があります。
・特殊システム仕様についてはご相談ください。



本社

〒601-8105
京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地

お問い合わせ先



TOWA (当社のハウスマーク)、 はTOWA株式会社の商標または登録商標です。

海外販売拠点

中国
TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
台湾
TOWA Taiwan Co., Ltd.
韓国
TOWA Korea Co., Ltd.
シンガポール
TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.
マレーシア
TOWA MALAYSIA SALES
& SERVICES SDN. BHD.
タイ
TOWA THAI COMPANY LIMITED

フィリピン
TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.
インド
TOWA SEMICONDUCTOR INDIA
PRIVATE LIMITED
ドイツ
TOWA Europe GmbH
オランダ
TOWA Europe B.V.
アメリカ
TOWA USA Corporation